

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成27年11月19日(2015.11.19)

【公開番号】特開2015-178635(P2015-178635A)

【公開日】平成27年10月8日(2015.10.8)

【年通号数】公開・登録公報2015-063

【出願番号】特願2015-121164(P2015-121164)

【国際特許分類】

C 08 J	3/24	(2006.01)
C 08 L	63/00	(2006.01)
C 08 L	61/06	(2006.01)
C 08 K	3/00	(2006.01)
C 08 L	101/00	(2006.01)
H 01 L	23/29	(2006.01)
H 01 L	23/31	(2006.01)

【F I】

C 08 J	3/24	Z
C 08 L	63/00	B
C 08 L	61/06	
C 08 K	3/00	
C 08 L	101/00	
H 01 L	23/30	R

【手続補正書】

【提出日】平成27年9月8日(2015.9.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

無機充填剤、エポキシ樹脂及びフェノール樹脂を含み、平面視投影面積が17663m²以上あり、

熱硬化前の弾性率が90～130の温度範囲において 2.5×10^3 Pa以上 3×10^4 Pa以下であり、

前記エポキシ樹脂の軟化点が50～130であるBステージ状態の熱硬化性樹脂シート。

【請求項2】

前記無機充填剤の平均粒径が54μm以下である請求項1に記載の熱硬化性樹脂シート。

【請求項3】

前記無機充填剤の含有量が70重量%以上95重量%以下である請求項1又は2に記載の熱硬化性樹脂シート。

【請求項4】

エラストマーを含む請求項1～3のいずれか1項に記載の熱硬化性樹脂シート。

【請求項5】

請求項1～4に記載の熱硬化性樹脂シートの長尺体がロール状に巻き取られた熱硬化性樹脂シート巻回体。

【請求項 6】

電子部品パッケージの製造方法であって、
一又は複数の電子部品を覆うように請求項1～4のいずれか1項に記載の熱硬化性樹脂シートを該電子部品上に積層する積層工程、及び

前記熱硬化性樹脂シートを熱硬化させて封止体を形成する封止体形成工程を含み、

前記熱硬化性樹脂シートの平面視投影面積に占める前記電子部品の平面視投影面積の割合が50%以上である電子部品パッケージの製造方法。

【請求項 7】

前記積層工程を熱プレス加工により行う請求項6に記載の電子部品パッケージの製造方法。

【請求項 8】

前記封止体をダイシングして電子部品モジュールを形成するダイシング工程をさらに含む請求項6又は7に記載の電子部品パッケージの製造方法。

【請求項 9】

前記電子部品が、半導体チップ又は半導体ウェハである請求項6～8のいずれか1項に記載の電子部品パッケージの製造方法。